

# 東南科技大學技術移轉授權合約書

東南科技大學(以下簡稱甲方) 機械工程系 黃仁清教授(以下簡稱乙方)將其所擁有之「石墨烯複合材料」技術(以下簡稱移轉標的)移轉給「王信記塑膠工業股份有限公司」(以下簡稱丙方),雙方同意本於誠信原則,協議下列條款,以為共同遵守:

- 一、 乙方將移轉標的以新台幣 80,000 元整之技轉授權金(以下稱技轉金)移轉給丙方,移轉標的授權內容明細詳如本合約附件一。  
授權日期自 104 年 7 月 1 日至 105 年 6 月 30 日止,授權地區為中華民國地區。
- 二、 前項技轉金之支付方式如下:  
技轉金應於簽約後三個月內一次付清給甲方。丙方所付技轉金,凡須由丙方扣繳稅款申報稽徵機關者,應依當時稅法規定辦理。收到丙方所付技轉金後由甲方依本校「智慧財產管理辦法」核撥權利金給乙方。
- 三、 乙方保證附件一所載之移轉標的,於簽約之前未將移轉標的做為質權之標的。所有移轉標的如有質權行為致丙方遭受權益損失時,乙方應負責賠償丙方。
- 四、 丙方在本合約中所有之權利義務,未經乙、丙方事前書面同意,不得讓與或轉授權予任何第三人。丙方若有違反,乙方得不經催告逕行終止本合約。
- 五、 丙方利用本移轉標的製造、使用或銷售任何產品、服務之行為與乙方均無關,應自負因此所生之一切法律責任。丙方如有任何侵害智慧財產權之行為或其他違法行為致遭受第三人請求或被訴時,其責任完全由丙方自負。如第三人因丙方製造、使用或銷售產品或服務之行為向乙方提出任何請求導致任何損失,丙方應補償之。
- 六、 丙方利用本移轉標的自行研發所產生之衍生技術,或有其他與移轉標的相關之技術研發成熟時,其智慧財產權歸屬丙方,但應通知乙方並依互惠原則優先將該技術移轉給丙方,移轉契約由雙方另訂之。
- 七、 丙方依移轉標的所製之專利產品,應依授權地區之有關法律為適當之標示。
- 八、 乙方擔保盡力協助丙方自行使用本技術,但不擔保本技術之可專利性、合用性及商品化之可能性。
- 九、 丙方若違反本合約之任何條款,乙方均得不經催告逕行終止本合約,並請求損害賠償。
- 十、 乙方應將移轉標的之相關技術說明文件於簽約時以紙本或電子檔方式交付給丙方。
- 十一、 本技術移轉程序如涉及專利授權登記,其申請登記所需之費用(含規費及代理人服務費)由丙方支付。
- 十二、 本合約得經雙方同意以書面修改增訂,並應將經雙方簽署之書面附於本合約之後,作為本合約之一部分,並取代已修改增訂之原條文。

十三、 本合約未規定事宜應依民法及其他相關規定辦理。

十四、 本合約應依中華民國之法律予以解釋及規範；雙方對於本合約、或因本合約而引起之疑義或糾紛，雙方同意先依誠信原則解決之。

十五、 本合約因爭議糾紛無法解決而涉訟時，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

十六、 本合約書正本壹式三份，由甲乙丙三方各執正本一份為憑。

立約人

甲 方：東南科技大學（印信）

校 長：李清吟（簽章）

地 址：新北市深坑區北深路3段152號



乙 方：黃仁清（簽章）

身分證字號：[REDACTED]

戶籍地址：[REDACTED]

丙 方：王信記塑膠工業股份有限公司（公司印信）

統一編號：33028296

簽約代表人：王豐任

地 址：新北市中和區中山路二段482巷17號2樓



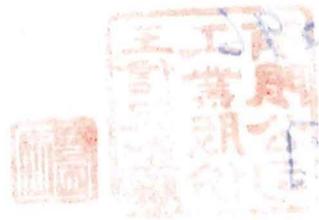
中 華 民 國 一〇四 年 六 月 三 十 日

【附件】技術移轉授權內容。

(一) 石墨烯複合材料技術

特點：

1. 提供石墨烯複合材料之製作技術
2. 適用於奈米複合材料製作
3. 可提升奈米複合材料之應用領域



## (二) 石墨烯複合材料技術相關資料

1. Jen-Ching Huang, Cheng-Yi Chiu, 2011, “The Study of Single-walled Nanotube Reinforced Epoxy Composites by Molecular Dynamics”, *Polymers & Polymer Composites*, Vol. 19, Nos. 4&5, pp. 377~382. (SCI:0.47) (Corresponding Authors)
2. Jen-Ching Huang and Yi-Chia Liao, “The Study on Model Establishment and Mechanical Property Evaluation of Nanocomposite Material by Molecular Dynamic Simulation”, *2010 International Conference on Clean Nano Process, Green Energy, Nanotechnology and Computational Mechanics (ICCGNC 2010)*, December 8, Taipei, Taiwan. (Corresponding Authors)